

**UNIT CONTROLLING PANEL, METHOD FOR SUBSTRATE DELIVERING TEST,
AND SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS**

**UNIT CONTROL PANEL, SUBSTRATE TRANSFER TEST METHOD,
AND SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS**

【技術分野】

【0001】

本発明は、ユニット制御盤、基板の受け渡しテスト方法、及び基板処理装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

近年、半導体ウェハなどの基板に対して各種処理を行うために基板処理装置が用いられている。基板処理装置は、例えば、基板の研磨処理を行うための研磨ユニット、基板の洗浄処理及び乾燥処理を行うための洗浄ユニット、及び基板の搬送処理を行うためのロード／アンロードユニット、などを備えて構成される。

【0003】

研磨ユニット、洗浄ユニット、及びロード／アンロードユニットはそれぞれ、ユニット単体で製造される。基板処理装置は、これら複数のユニットを組み立てて、複数のユニット間で基板の受け渡しを行いながら基板に対して一連の処理を行うのが一般的である。すなわち、ロード／アンロードユニットは、処理対象の基板を研磨ユニットへロードする（渡す）。研磨ユニットは、ロード／アンロードユニットによってロードされた基板に対して研磨処理を行う。洗浄ユニットは、研磨ユニットによって研磨処理された基板を受け取って、洗浄処理及び乾燥処理を行う。ロード／アンロードユニットは、洗浄ユニットによって乾燥された基板をアンロードする（受け取る）。

【0004】

ところで、基板処理装置は、複数のユニットを組立てた後に、すぐに本稼働をするのではなく、まずは基板処理装置の立ち上げ作業（テスト運転）を行うのが一般的である。立ち上げ作業としては、ユニット個々の処理が適正に行われるか否かのテスト、及び複数のユニット間で基板の受け渡しが適正に行われるか否かのテストなどが挙げられる。

【先行技術文献】